

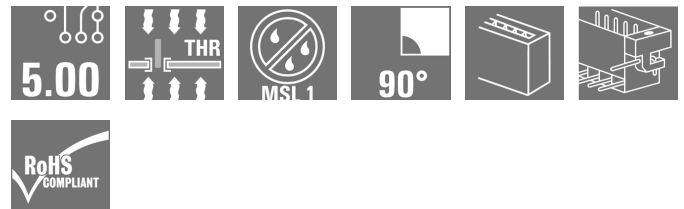
**SL-SMT 5.00HC/05/90LF 1.5AU BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Термостойкий штекерный соединитель, упаковка — коробка или лента. На ленте и с выводами под пайку 1,5 мм оптимизирован для автоматического монтажа. Длина выводов 3,2 мм подходит для пайки волной припоя и оплавлением сквозных отверстий (Reflow). Штекерные соединители обеспечивают место для маркировки и допускают кодирование. HC = высокоточный.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 5.00 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина контактного штифта (l): 1.5 mm, позолоченный, черный, Ящик
Номер для заказа	<a href="#">1177420000</a>
Тип	SL-SMT 5.00HC/05/90LF 1.5AU BK BX
GTIN (EAN)	4032248971152
Кол.	48 Шт.
Продуктивное отношение	IEC: / 27.5 A UL: / 18.5 A

Упаковка Ящик  
Дата создания 7 апреля 2021 г. 6:38:52 CEST

## SL-SMT 5.00HC/05/90LF 1.5AU BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	10 мм	Высота (в дюймах)	0,394 inch
Высота, мин.	8,5 мм	Глубина	12 мм
Глубина (дюймов)	0,472 inch	Масса нетто	3,167 g
Ширина	34,8 мм	Ширина (в дюймах)	1,37 inch

## Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	40 мм
VPE с	70 мм	Высота VPE	160 мм

## Системные характеристики

Серия изделия	OMNIMATE Signal – серия BL/SL 5.00	Вид соединения	Соединение с платой
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку	Шаг в мм (P)	5 мм
Шаг в дюймах (P)	0,197 inch	Угол вывода	90°
Количество полюсов	5	Длина контактного штифта (l)	1,5 мм
Допуск на длину выводов под пайку	+0,1 / -0,2 mm	Размеры выводов под пайку	d = 1,2 мм, восьмиугольный
Размеры выводов под пайку = допуск d0 / -0,03 mm		L1 в мм	20 мм
L1 в дюймах	0,787 inch	Количество полюсных рядов	1
Объемное сопротивление	≤5 mΩ	Усилие вставки на полюс, макс.	7 N
Усилие вытягивания на полюс, макс.	5,5 N		

## Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP GF	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Материал контакта	CuMg	Поверхность контакта	позолоченный
Структура слоев соединения под пайку	1...3 μm Ni / 2...4 μm Sn матовый	Структура слоев штепсельного контакта	1...3 μm Ni / 2...4 μm Sn / 1.7...2.3 μm Au
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Рабочая температура, мин.	-50 °C	Рабочая температура, макс.	100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.	-30 °C	Температурный диапазон монтажа, макс.	100 °C

## Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту	IEC 60664-1, IEC 61984	Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	27,5 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)	19 A	Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	24 A
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)	16,5 A		

## Номинальные характеристики по CSA

Номинальный ток (группа использования V/CSA)	15 A	Номинальный ток (группа использования D/CSA)	15 A
--	------	--	------

**SL-SMT 5.00HC/05/90LF 1.5AU BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Номинальные характеристики по UL 1059**

Институт (UR)



Сертификат № (UR)

E60693

Номинальный ток (группа использования В/UL 1059)

Ссылка на утвержденные значения

В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

18,5 А

**Классификации**

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01

**Важное примечание**

Соответствие IPC

Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.

Примечания

- Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E60693

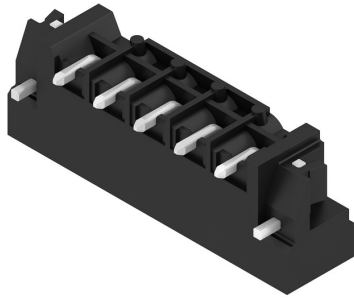
**SL-SMT 5.00HC/05/90LF 1.5AU BK BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

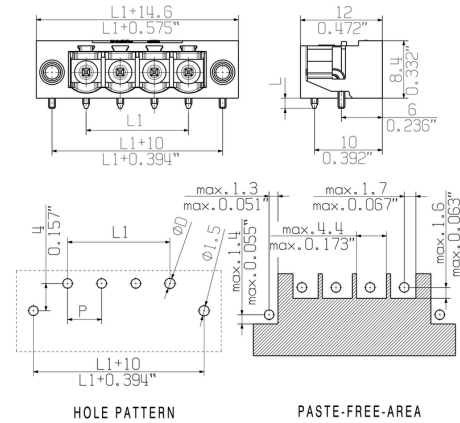
www.weidmueller.com

**Изображения**

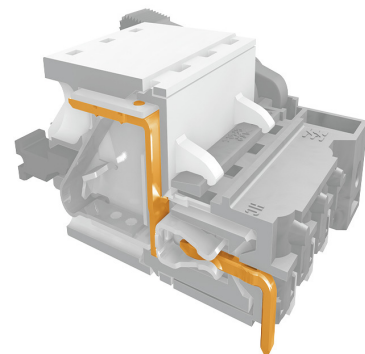
**Изображение изделия**



**Dimensional drawing**



**Преимущество изделия**



Safe power transmission  
 Proven properties

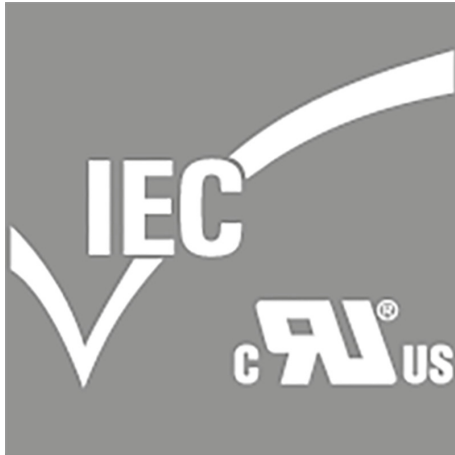
**SL-SMT 5.00HC/05/90LF 1.5AU BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Преимущество изделия**



Compliant with existing standards

## Recommended wave soldering profiles

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### Single Wave:



### Double Wave:



### Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



### Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.